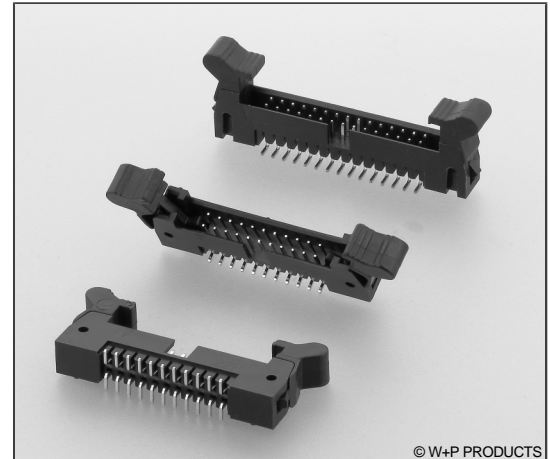


SMT-Wannenstiftleisten mit Verriegelung RM 2,00mm, stehend SMT Box Headers with Latches, 2.00mm Pitch, Vertical

Technische Daten / Technical Data

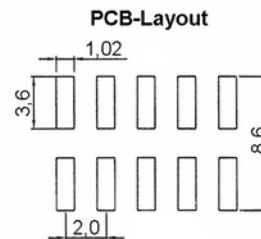
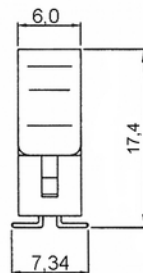
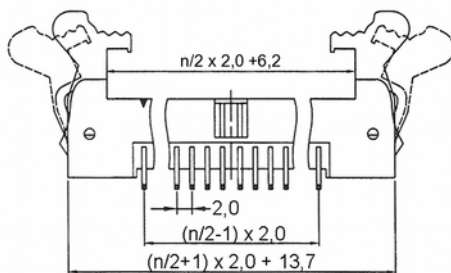
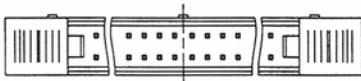
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.50mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

343



Series

2380

Contacts*

44

10-16 20-24
26 30 34 40
44 50 68

Plating*

00

00 Vergoldet
Gold plated
60 Sel. Au/Sn

Packaging*

PPST

ST
PPST
PPTR (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads

PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

